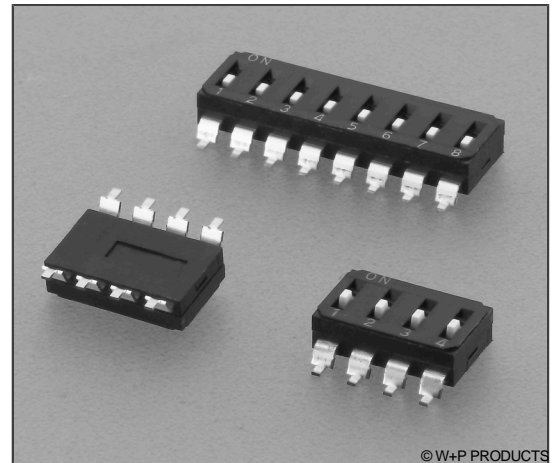


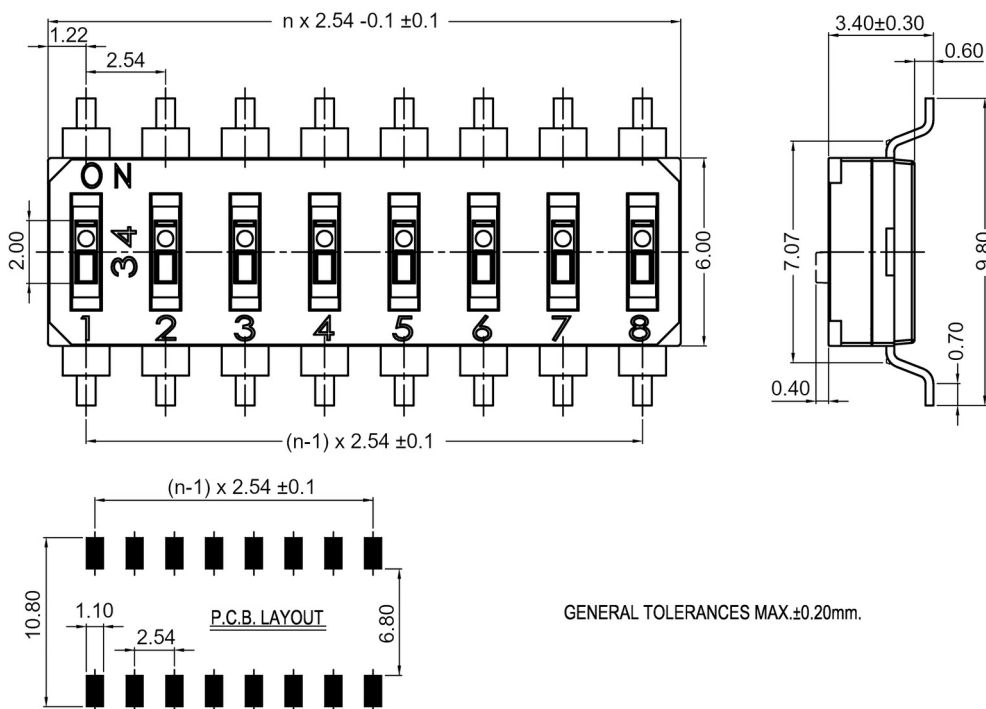
### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Gehäuse: schwarz; Hebel: weiß
Colour	Housing: black; actuator: white
Kontaktmaterial	Messing, vergoldet über Nickel
Contact Material	Brass, gold plated over nickel
Kontaktbelastbarkeit	24V <sub>DC</sub> , 25mA im Schaltvorgang
Contact Rating	24V <sub>DC</sub> , 25mA at mate and break
Durchgangswiderstand	< 100 mΩ at initial state
Contact Resistance	< 100 mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	> 100 MΩ at 500V <sub>DC</sub>
Spannungsfestigkeit	500 V DC
Test Voltage	500 V DC
Temperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
Temperature Range	-20 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Schaltkraft: 1.000gf max  
Switching Force: 1.000gf max  
Schaltweg: 1mm  
Switching Path: 1mm  
Lebensdauer: min. 2000 Schaltungen/Schalter  
Lifespan: min. 2000 operations/switch



<b>Series</b>	<b>Circuits*</b>	<b>Actuators*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>5044</b>	<b>04</b>	<b>20</b>	<b>ST</b>
	02-10 12	10 Hohe Hebel Raised actuators 20 Versenkte Hebel, mit Folie versiegelt Recessed actuators, top tape sealed	ST TR

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**TR** Tape & Reel (Option) / Tape & Reel (Option)

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

